

Title (en)

Process for making silver/MeO contact plates with a solderable or weldable backing.

Title (de)

Verfahren zum Herstellen von Silber/MeO-Kontaktplättchen mit lötfähiger Unterseite.

Title (fr)

Procédé de fabrication de plaquettes à contact en argent/Meo ayant une face soudable ou pouvant être brasée.

Publication

**EP 0283536 A1 19880928 (DE)**

Application

**EP 87104366 A 19870324**

Priority

EP 87104366 A 19870324

Abstract (en)

2.1 Contact plates of silver/MeO material, in particular with oxide components arranged perpendicular to the contact surface, cannot be soldered or welded directly to contact supports. 2.2 In order to facilitate this, the invention proposes applying solderable or weldable metals or alloys during the flame or plasma spraying. <IMAGE>

Abstract (de)

2.1 Kontaktplättchen aus Silber/MeO-Werkstoff, insbesondere mit senkrecht zur Kontaktfläche angeordneten Oxidanteilen, können nicht direkt auf Kontaktträger aufgelötet oder aufgeschweißt werden. 2.2 Um dies zu ermöglichen, wird nach der Erfindung vorgeschlagen, lötfähige oder schweißfähige Metalle beziehungsweise Legierungen im Wege des Flamm- oder Plasmaspritzens aufzutragen.

IPC 1-7

**H01H 1/02**

IPC 8 full level

**H01H 1/023** (2006.01)

CPC (source: EP)

**H01H 1/0231** (2013.01)

Citation (search report)

- [Y] FR 2312846 A1 19761224 - BBC BROWN BOVERI & CIE [CH]
- [YD] DE 1232282 B 19670112 - GIBSON ELECTRIC COMPANY
- [A] EP 0115292 A2 19840808 - SIEMENS AG [DE]
- [AD] EP 0022980 A1 19810128 - DORNIER SYSTEM GMBH [DE], et al
- [A] FR 1332855 A 19630719 - SIEMENS AG

Cited by

RU2768068C1; DE4331913A1; EP0673046A1; US5520323A; US5598629A; US5799771A; WO9311550A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0283536 A1 19880928**

DOCDB simple family (application)

**EP 87104366 A 19870324**